

# 导热硅胶薄材/XK-R50

## 简介:

XK-R 系列为无基材硅胶导热薄材, 比传统玻纤布更好的导热与填缝能力, 导热系数 1~4.8W/mk , 比传统硅胶片更薄的界面厚度(BLT), 适合 0.2~0.5mm 范围的价格竞争的应用。

## 特性:

超薄厚度( 0.2~0.5mm )

无基材设计

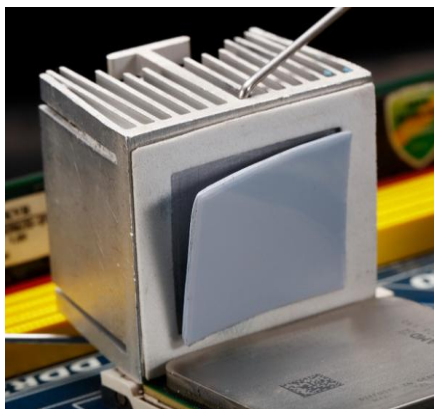
适当的压缩性

高性价比

## 应用:

消费性电子产品

自动化设备、军规设备、医疗设备



|                           | unit              | XK-R50            | Method     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Color                     |                   | Gray              |            |
| Thickness                 | mm                | 0.2~10            | ASTM D374  |
| Specific Gravity          | g/cm <sup>3</sup> | 3.2               | ASTM D792  |
| Hardness                  | Shore A           | 60                | ASTM D2240 |
| Thermal Conductivity      | W/mK              | 4.8               | HOT DISK   |
| Volume Resistivity        | Ωcm               | >10 <sup>13</sup> | ASTM D257  |
| Breakdown Voltage         | KV/mm             | 13                | ASTM D149  |
| Dielectric Constant       | 1                 | 8                 | ASTM D150  |
| Application temperature   | °C                | -50~200           |            |
| Tensile strength          | psi               | 60                | ASTM D149  |
| Elongation                | %                 | 40                | ASTM D149  |
| Siloxane Volatiles D4~D20 | %                 | <0.01             | GC-FID     |
| Flammability              | UL94              | V-0               | UL94       |